



2025年 上半年度法人説明會

尼得科超眾科技股份有限公司
Nidec Chaun-Choung Technology Corp.

August 29th, 2025



聲明

本簡報與其發佈之相關消息，包括公司內部與外部來源所取得的預測性資訊，具有不確定性風險。實際結果可能與這些預測性資訊的評估有所出入。

簡報中對未來的展望係本公司截至目前的看法。未來這些看法若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。



- 公司簡介
- 重點發展：市場、產品與競爭優勢
- 1H, 2025 財務結果
- 問與答 (Q & A)

公司簡介 公司概况

- 董事長暨執行長：三好昭宏
- 創設日期： 1973年12月14日
- 股票上市：代號6230
- 主要股東：
Nidec 持股達 86.30% (2025年7月)
- 實收股本：863,434 仟元
- 公司地址：新北市三重區中興北街184-3號
- 主營業務：散熱模組、散熱片、熱導管及微均熱板
- 海外工廠及辦公室







1

專業熱技術團隊與持續創新

擁有跨散熱模擬、材料開發與製程優化的專業團隊，研發Heat Pipe、Vapor Chamber、3D VC、超薄熱管及水冷模組。透過與國際客戶聯合開發，快速應對AI、HPC等高熱通量應用，保持技術領先。

2

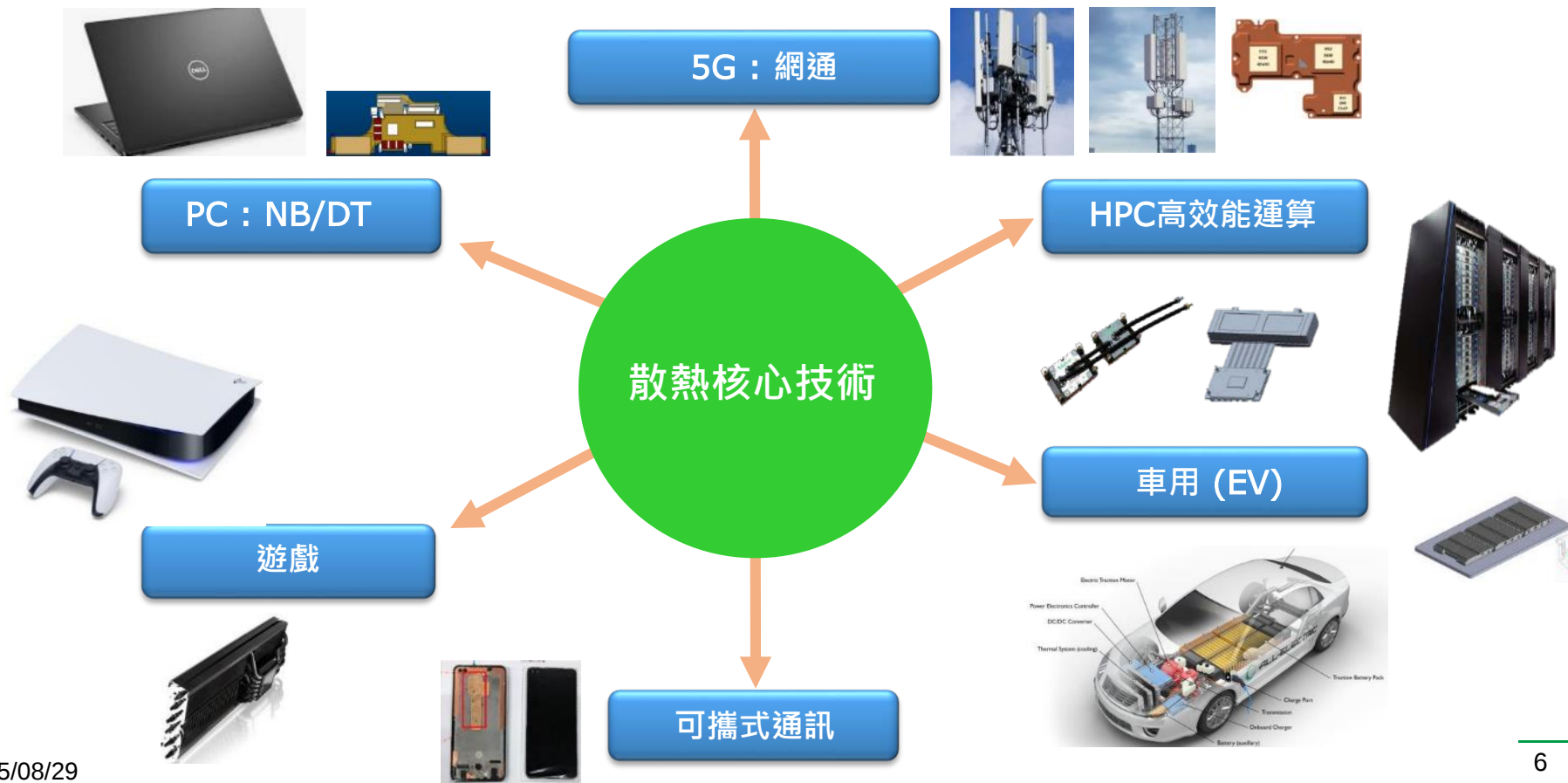
集團資源整合與全球佈局

與Nidec集團協同開發風扇與水冷零組件，製造基地遍及台灣、昆山、重慶，具大規模模組化生產與完整測試能力，支援AI伺服器、網通及終端產品散熱需求。

3

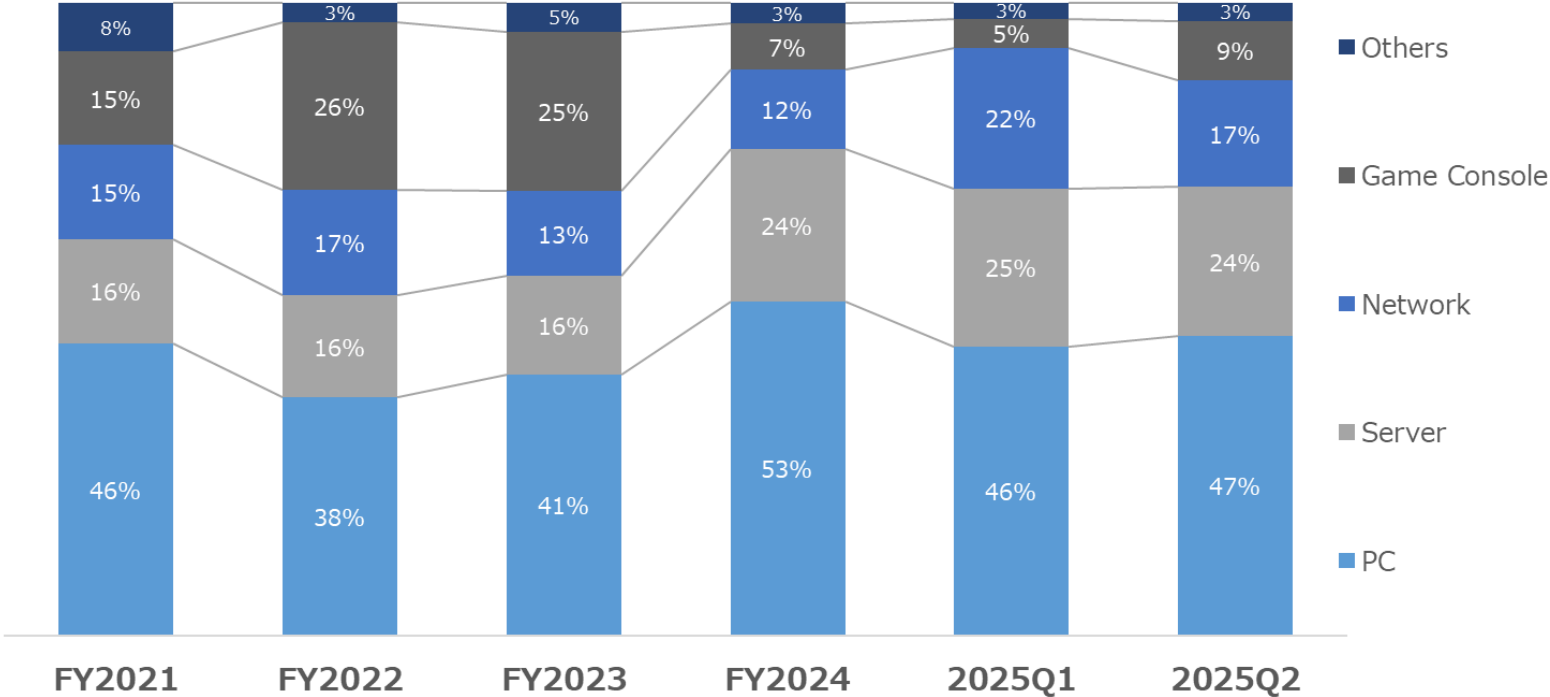
市場導向產品線與客製化能力

產品覆蓋10W NB至10kW AI Server，Slim VC、3D VC、超長及大直徑熱管已量產，產品藍圖與AI/HPC/伺服器市場成長高度契合。



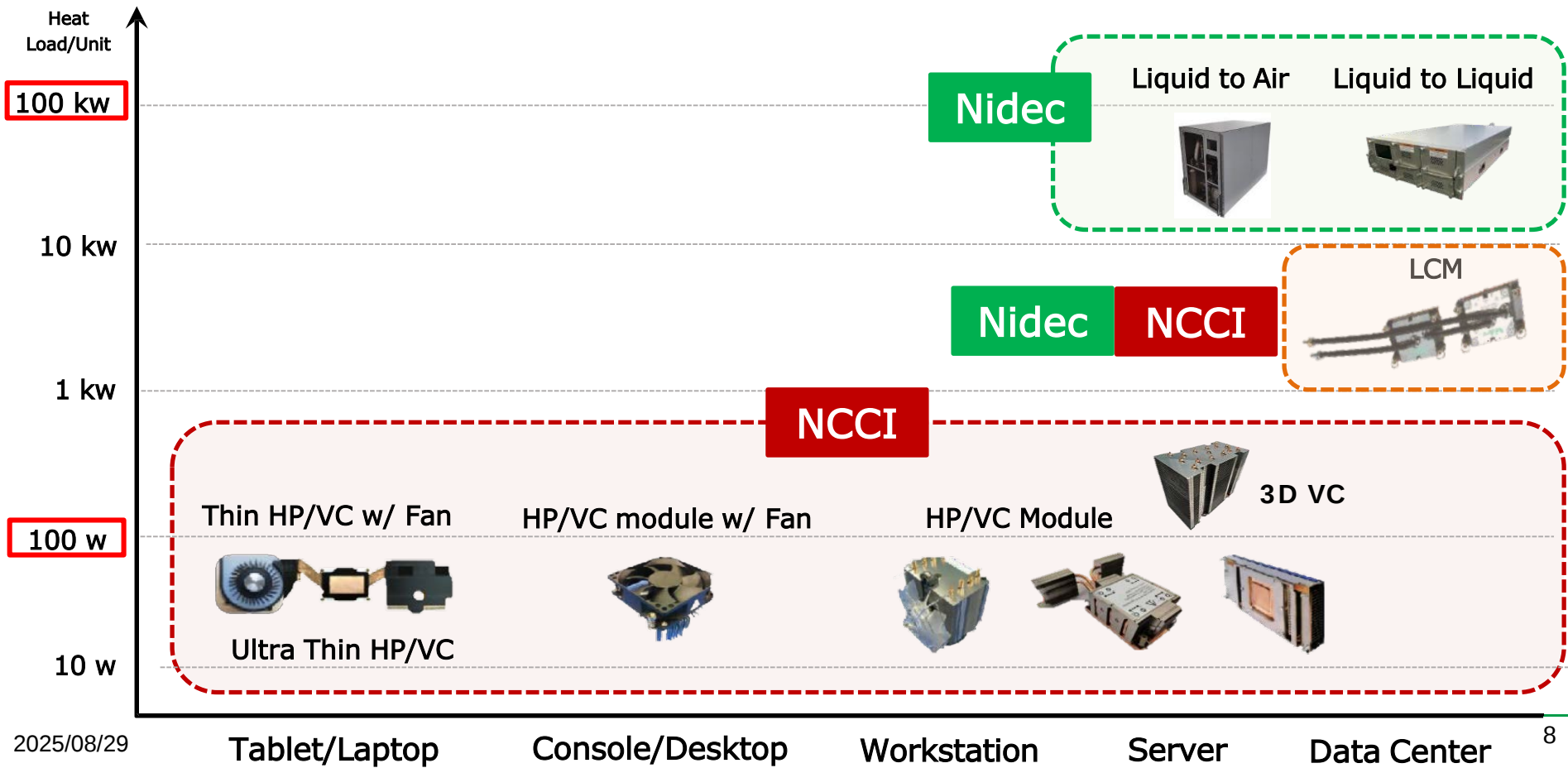


產品組合





NCCI 散熱產品線



現在



Thermal Solution for AI Laptop
D6/D8 Heat pipe Solution CPU+GPU 25~60 Watts



Thermal Solution for Gaming Laptop
Slim VC ($1.4\text{mm} \leq t \leq 2.5\text{mm}$) CPU+GPU 90~220 Watts



AI人工智慧產品



Big diameter Heat pipe for CPU & GPU

Heat pipe diameter : 6mm → 10mm



Slim VC Solution for CPU & GPU

VC thickness : 1.4mm → 1.2mm



Big diameter Heat pipe for CPU & GPU

Heat pipe diameter : 8mm → 12mm



未來



Thermal Solution for AI Laptop
D10 Heat pipe Solution CPU+GPU 25~80 Watts



Thermal Solution for Gaming Laptop
Slim VC ($1.2\text{mm} \leq t \leq 3.0\text{mm}$) CPU+GPU 90~280 Watts



Thermal Solution for AIO & Desk Top Laptop
D10/D12 Heat pipe Solution CPU+GPU 35~95 Watts



現在



One CPU solution: 500W
Heat pipe length < 400mm



D8 Heat pipe, CPU < 600W



GPU = 700W

Long Heat pipe for Cloud Server

CPU solution : 500W → 1000W

Heat pipe length : 400mm → 600mm

Big diameter Heat pipe for Next generation server CPU

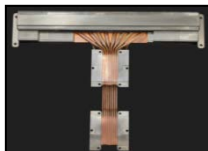
CPU solution : 600W → 700W

Heat pipe diameter : 8mm → 10mm

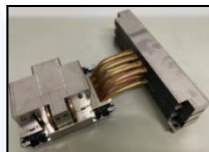
Hi-Power 3D VC Thermal Solution for AI Server

High power : 700W → 1000W

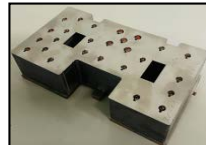
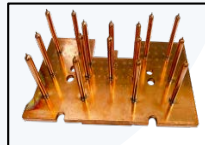
未來



Two CPU solution : Total 1000W
Heat pipe length > 600mm



D10 Heat pipe, CPU > 700W

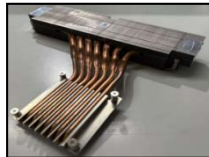


GPU > 1200W

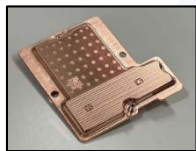
現在



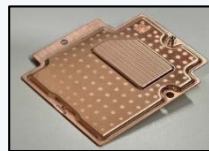
430 W HP solution



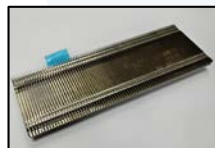
500 W HP solution



103 W



152 W



13 W

Hi-Power Air Cooling Solution for Switch

Heatpipe/VC module : 400W → 850W

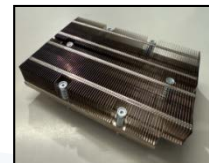
VC Solution for Radio Base Station Product

VC : 100W → 255W

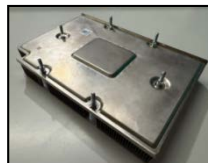
VC Solution for Network Card

VC : 10W → 25W

未來



850 W VC solution

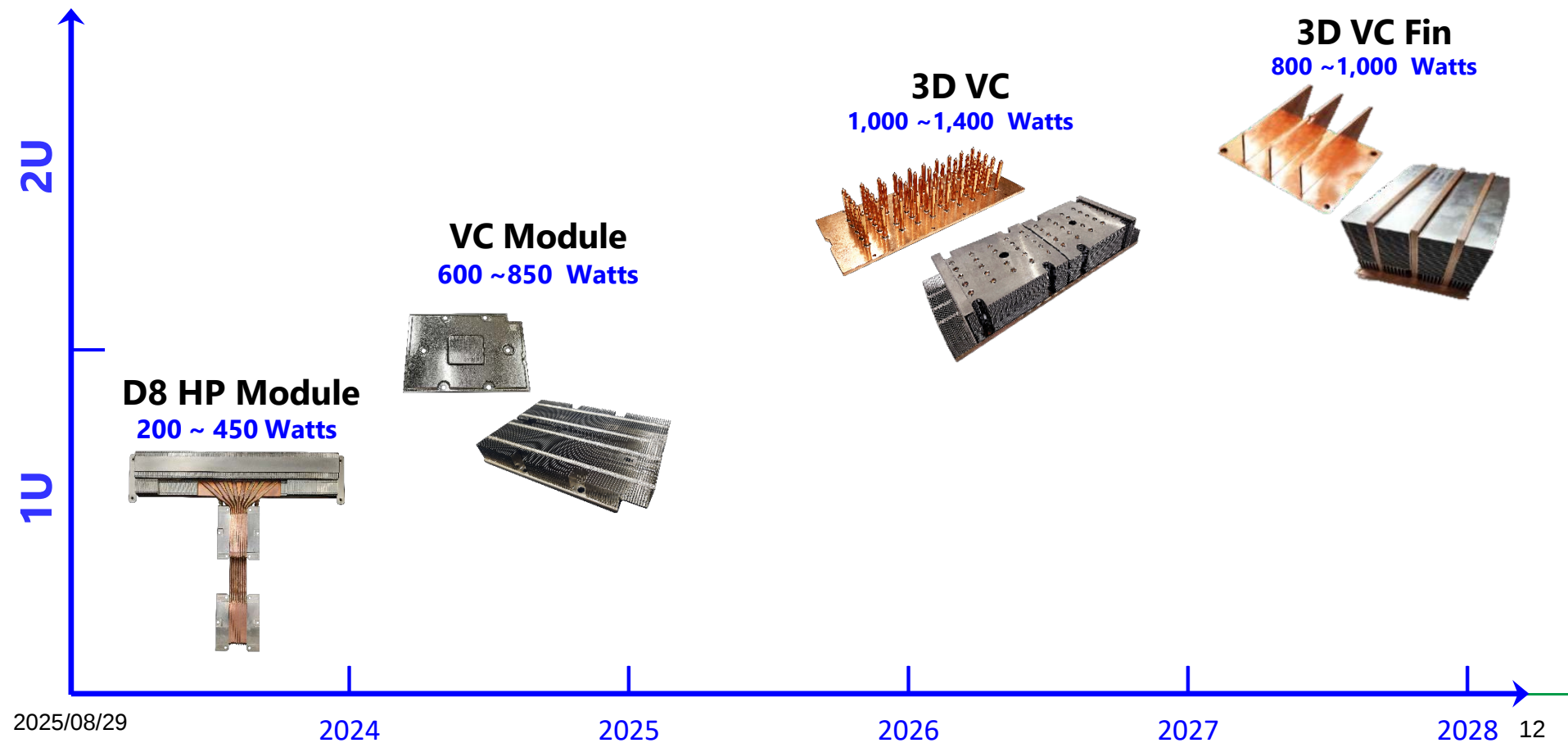


225 W



23 W

NCCI高瓦數氣冷方案





GPU & CPU LCM Engineering Testing Fixture



Inner Manifold

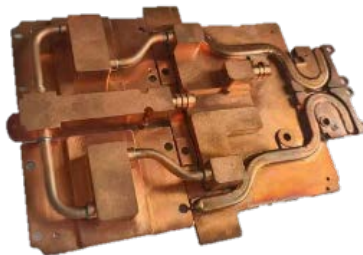


CPU LCM & Standard Cold plate

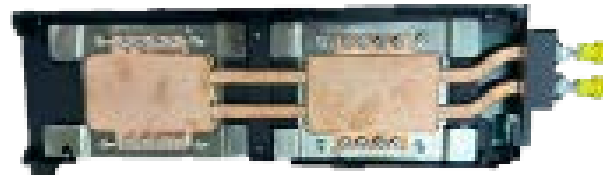


Intel CPU		AMD CPU
EGS 350W  • R :0.027°C/W • ΔP: 2.77kPa	BHS SP 350W  • R :0.031°C/W • 2.75 kPa	Milan SP3 225W  • R :0.032°C/W • ΔP: 3.22 kPa
Whitley 280W  • R :0.039°C/W • ΔP: 2.95 kPa	BHS AP 500W  • R :0.024°C/W • ΔP: 3.42 kPa	Genoa SP5 500W  • R :0.025°C/W • ΔP: 2.75 kPa

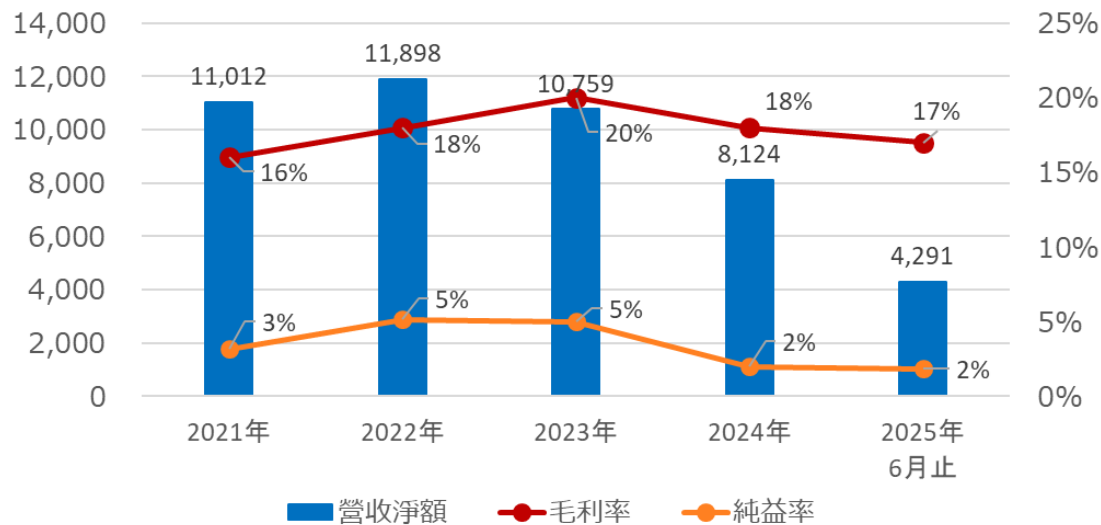
CPU LCM



ASIC & PCIE LCM



經營實績



年度 項目	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年 6月止
營收淨額	11,012	11,898	10,759	8,124	4,291
毛利率	16%	18%	20%	18%	17%
純益率	3%	5%	5%	2%	2%
EPS	4.05	7.10	7.02	1.48	0.80

Q & A

